

2-1-2-37 SR 回路形状転写／SR 线路形状的转移／Conductor pattern transferred on solder resist

【特徴】SR 表面に他の回路形状が転写している状態の欠陥

【特征】在 SR 表面转移来其它线路形状的缺陷。

【Characteristics】The pattern of a conductor of another board is transferred on the solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 表面に他の製品が重ねられ強く圧着されたことにより回路形状が転写する形で、できたもの（SR 塗布工程後）

【原因、判断要点、发生工序】SR 表面受到其它产品的强烈挤压，转移来其它的线路形状而引起的（涂布 SR 工序后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by the transfer of a conductor pattern of a board to the solder resist surface of stacked another board by strong pressure. (After solder resist application)



【コメント】穴埋めスルーホール上にも転写顕微鏡倍率×

【注釋】甚至转移到埋孔上显微镜倍率×

【Comments】Transferred on plugged through-hole surface Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

2-1-2-38 端子部傷状P SR 残り／插脚伤痕部的 PSR / Threadlike photo solder resist residue on edge board contact

【特徴】金端子表面に線状のP SR が残っている状態の欠陥

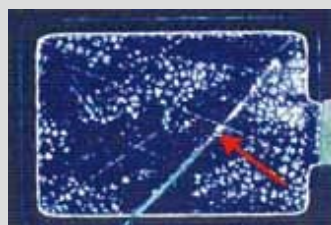
【特征】在镀金插脚表面留下线状 PSR 的缺陷。

【Characteristics】Threadlike photo solder resist residue is left on a gold-plated edge board contact

【原因・判断ポイント・発生工程】P SR 用 AWF の傷により、P SR が露光され、現像残りして出来たもの（AWF 作製工程、P SR 露光焼付～P SR 現像工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于 PSR 的 AWF 划伤，PSR 被曝光、显影残留下来而引起的（AWF 制作工序、PSR 曝光～显影工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Photo solder resist is exposed by a phototool with a scratch and the solder resist of the scratched part remains undeveloped. (Phototool preparation, photo solder resist exposure - development process)



【コメント】顕微鏡倍率×50

【注釋】显微镜倍率×50

【Comments】Magnification: ×50